

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 16-bit PIC24/dsPIC](#)

Topic: [關於dsPIC30F6010 package的問題](#)

Subject: Re: [關於dsPIC30F6010 package的問題](#)

作者: Ryang

2004年06月25日 09:35:35

Microchip 對 dsPIC30F6010 包裝的原文說明如下：

The dsPIC30F6010 will only fit into the larger PF packages. When the dsPIC30F010A optimized die size devices are available, the die will be assembled in both the smaller PT and larger PF packages.

所以目前是以 PF 這個比較大一點的封裝，待 A Version 出來時就會同時有 PF & PT 兩種包裝。